



(11) **EP 2 287 586 A3**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:
04.07.2012 Patentblatt 2012/27

(51) Int Cl.:
G01L 19/08 ^(2006.01) **G01D 3/02** ^(2006.01)
A61B 5/00 ^(2006.01) **H01L 23/48** ^(2006.01)

(43) Veröffentlichungstag A2:
23.02.2011 Patentblatt 2011/08

(21) Anmeldenummer: **10194392.6**

(22) Anmeldetag: **07.07.2004**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB

(30) Priorität: **19.07.2003 DE 10332878**

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en)
nach Art. 76 EPÜ:
04766151.7 / 1 673 812

(71) Anmelder: **Infineon Technologies AG**
85579 Neubiberg (DE)

(72) Erfinder:
• **Bauer, Robert**
85665, Moosach (DE)
• **von Hagen, Jochen**
83043 Bad Aibling (DE)

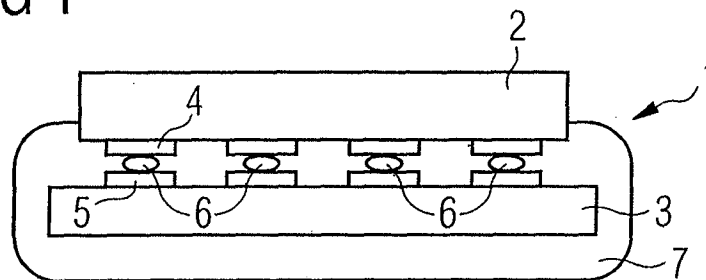
(74) Vertreter: **Karl, Frank**
Kindermann Patentanwälte
Postfach 100234
85593 Baldham (DE)

(54) **Integrierte Sensor-Chip-Einheit**

(57) Die Erfindung betrifft einen Sensorbaustein, insbesondere einen Messwertaufnehmer (2) zur Ermittlung von Messdaten und eine Schaltungsanordnung (3) zum Ermöglichen einer drahtlosen Energieversorgung und Abfrage der Messdaten. Der Messwertaufnehmer ist als integrationsfähiger Sensor (2) ausgebildet, und die

Schaltungsanordnung als integrierter Halbleiterschaltungsbaustein (3), wobei der Sensor (2) und der Halbleiterschaltungsbaustein (3) mit Mitteln der Mikrosystemtechnik mechanisch und elektrisch leitend miteinander zu einer integrierten Sensor-Chip-Einheit (1) verbunden sind.

FIG 1



EP 2 287 586 A3



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 10 19 4392

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	WO 00/58752 A1 (MICROCHIP TECH INC [US]) 5. Oktober 2000 (2000-10-05) * Seite 4, Zeilen 5-28 * * Seite 6, Zeile 4 - Seite 7, Zeile 21 * * Abbildungen 2A,2B * -----	1-20	INV. G01L19/08 G01D3/02 ADD. A61B5/00 H01L23/48
X	US 5 833 603 A (KOVACS ET AL) 10. November 1998 (1998-11-10) * Spalte 4, Zeilen 35-44 * * Spalte 6, Zeile 9 - Spalte 7, Zeile 12 * * Spalte 8, Zeilen 14-31 * * Spalte 11, Zeile 30 - Spalte 12, Zeile 15 * * Spalte 18, Zeilen 15-23 * * Abbildungen 1,2,4,12 * -----	1-13	
X A	JP 2001 291181 A (RICOH ELEMEX CORP) 19. Oktober 2001 (2001-10-19) * das ganze Dokument * -----	1,2,4, 6-12 19	
A	US 5 144 843 A (TAMURA MORIO [JP] ET AL) 8. September 1992 (1992-09-08) * Spalte 12, Zeile 67 - Spalte 13, Zeile 17 * * Spalte 17, Zeilen 23-46 * * Abbildungen 5,24 * -----	13,14	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) G01L
A	US 2002/113694 A1 (MUIRHEAD SCOTT A W [CA]) 22. August 2002 (2002-08-22) * Absätze [0018], [0054], [0108] * -----	1,16	
	-/--		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Berlin		Abschlußdatum der Recherche 29. Mai 2012	Prüfer Weis, Thomas
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

1
EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 10 19 4392

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
A	GB 2 308 947 A (I D SYSTEMS LTD [GB]) 9. Juli 1997 (1997-07-09) * Seite 2, letzter Absatz - Seite 4, letzter Absatz * * Seite 6 * * Seite 8, letzter Absatz - Seite 9, Absatz 1 * * Abbildung 1 * -----	1-20	
A	WO 01/33635 A1 (STMICROELECTRONICS SA) 10. Mai 2001 (2001-05-10) * Seite 1, Zeilen 5-11 * * Seite 6, Zeilen 28-33 * * Abbildung 10 * -----	1,3,8	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTER SACHGEBIETE (IPC)
Recherchenort Berlin		Abschlußdatum der Recherche 29. Mai 2012	Prüfer Weis, Thomas
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

1
EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 10 19 4392

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

29-05-2012

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0058752 A1	05-10-2000	AT 302422 T	15-09-2005
		CN 1302381 A	04-07-2001
		DE 60021971 D1	22-09-2005
		DE 60021971 T2	18-05-2006
		EP 1084423 A1	21-03-2001
		JP 2002540699 A	26-11-2002
		TW 494245 B	11-07-2002
		US 6720866 B1	13-04-2004
		WO 0058752 A1	05-10-2000

US 5833603 A	10-11-1998	AU 2401597 A	01-10-1997
		BR 9707974 A	27-07-1999
		CA 2248965 A1	18-09-1997
		EP 0888079 A1	07-01-1999
		JP 2000506410 A	30-05-2000
		US 5833603 A	10-11-1998
		WO 9733513 A1	18-09-1997

JP 2001291181 A	19-10-2001	KEINE	

US 5144843 A	08-09-1992	DE 68919471 D1	05-01-1995
		EP 0381775 A1	16-08-1990
		US 5144843 A	08-09-1992
		WO 9001153 A1	08-02-1990

US 2002113694 A1	22-08-2002	KEINE	

GB 2308947 A	09-07-1997	KEINE	

WO 0133635 A1	10-05-2001	EP 1226609 A1	31-07-2002
		FR 2800909 A1	11-05-2001
		JP 2004500706 A	08-01-2004
		US 6787869 B1	07-09-2004
		WO 0133635 A1	10-05-2001

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

专利名称(译)	集成传感器芯片单元		
公开(公告)号	EP2287586A3	公开(公告)日	2012-07-04
申请号	EP2010194392	申请日	2004-07-07
[标]申请(专利权)人(译)	英飞凌科技股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	英飞凌科技股份公司		
当前申请(专利权)人(译)	英飞凌科技股份公司		
[标]发明人	BAUER ROBERT VON HAGEN JOCHEN		
发明人	BAUER, ROBERT VON HAGEN, JOCHEN		
IPC分类号	G01L19/08 G01D3/02 A61B5/00 H01L23/48		
CPC分类号	A61B5/145 A61B5/14532 G01D3/022 G01L19/086 H01L23/48 H01L2224/05568 H01L2224/05573 H01L2224/16 H01L2924/00014 H01L2224/05599		
代理机构(译)	KARL , FRANK		
审查员(译)	WEIS , THOMAS		
优先权	10332878 2003-07-19 DE		
其他公开文献	EP2287586A2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

集成传感器芯片单元 (1) 具有用于无线能量供应和轮询测量数据的电路装置。该装置是与集成兼容的传感器 (2) , 并且电路装置是集成的半导体部件 (3) 。传感器和组件通过微系统技术布置连接 , 以制造集成的传感器芯片单元。

FIG 1

